

台灣積體電路製造股份有限公司 公告

主旨：本公司訂於115年2月24日（星期二）辦理「臺南科學工業園區特定區(開發區塊A)新建半導體廠計畫」環境影響說明書公開會議，特此公告周知。

依據：「開發行為環境影響評估作業準則」第15條。

公告事項：

- 一、會議時間：115年2月24日（星期二）下午2時00分
- 二、會議地點：中榮農村社區活動中心2樓（地址：臺南市安定區中榮里許中營27之1號）。
- 三、聯絡人及聯絡方式：劉芸汶 03-5636688 分機 7524388；ywlius@tsmc.com。
- 四、本公司於公開會議10日前將會議時間、地點及主要內容刊登於環境部環評開發案論壇網站(<https://eiadoc.moenv.gov.tw/eiaforum/>)；且以書面將相關會議訊息告知本開發行為之目的事業主管機關、開發行為基地所在地之直轄市或縣（市）政府、直轄市或縣（市）議會、鄉（鎮、市、區）公所、鄉（鎮、市）代表會及鄉（鎮、市、區）之村（里）長辦公處等。
- 五、開發行為
 - (一)開發行為名稱：「臺南科學工業園區特定區(開發區塊 A)新建半導體廠計畫」。
 - (二)開發單位：台灣積體電路製造股份有限公司。
 - (三)開發場所：計畫基地位於臺南市安定區，臺南科學工業園區特定區之開發區塊 A 範圍，北側鄰近市道 178 線，西側為直加弄大道，南側臨接「樹谷園區」，東側臨接南部科學園區管理局「臺南園區」。
 - (四)開發行為概述：在當前科技迅速演進的時代，半導體技術、人工智慧（AI）及大數據已成為驅動全球經濟與產業轉型的核心力量。為滿足市場對高效能晶片及先進運算技術的需求，並持續鞏固臺

灣半導體產業的國際領先地位、厚植先進製程技術及強化競爭優勢，台積公司規劃於臺南科學工業園區特定區之開發區塊 A 土地內興建半導體廠房及相關設施，計畫基地面積約 15.46 公頃，以持續發展先進製程並充分發揮產能群聚效益。

六、會議議程：

- (一) 主席致詞。
- (二) 開發單位簡報或說明。
- (三) 與會者表達意見。
- (四) 開發單位回應說明。
- (五) 結論。
- (六) 散會。

七、會議當日若因颱風或水災等不可抗力之原因，本公司或主持人得終止會議之進行，並另行通知舉辦時間、地點。